

## **格科微有限公司**

# **关于募投项目12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产的自愿性披露公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年8月31日，格科微有限公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”BSI产线投片成功，首个晶圆工程批取得超过95%的良率，标志着BSI产线顺利进入风险量产，即将进入大规模量产阶段。

该项目投产后，公司将具备12英寸BSI晶圆后道工序生产能力，将有力保障12英寸晶圆的供应，实现对关键制造环节的自主可控，缩短产品交期，把握中高阶CIS市场持续增长的巨大红利，增厚公司的盈利空间，提升公司在整个行业内的竞争能力与市场地位。该项目还有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度，提高公司整体竞争力，有助于公司积极响应下游应用领域对背照式图像传感器日益提升的需求，为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。

由于该项目达到预计产能尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品销售价格或原材料价格波动、因市场需求变化导致产能消化能力不足、资产折旧摊销增加等风险。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年9月3日